

Trocken-Plasmaschneiden

Das Trocken-Plasmaschneiden wird oft auch als konventionelles oder als Standard-Plasmaschneiden bezeichnet. Die geschichtliche Entwicklung muss jedoch differenzierter betrachtet werden. Beim konventionellen Plasmaschneiden wird der Lichtbogen lediglich durch den Innendurchmesser der Düse fokussiert (siehe Filmausschnitt).



Dieses Verfahren konnte durch Kjellberg Finsterwalde und Manfred von Ardenne weiterentwickelt werden. Es entstand das Plasma-Feinstrahl-Schneiden, das 1965 patentiert wurde - bekannt als **FineFocus-Technologie**. Durch die zusätzliche Einschnürung des Plasmastrahles mittels Sekundärmedium (zum Beispiel Gas) konnte die Winkelabweichung im Vergleich zum konventionellen Plasmaschneiden grundlegend verbessert werden. Die verfahrensbedingt typisch schrägen Schnittflächen gehörten damit der Vergangenheit an.

Kjellberg Finsterwalde arbeitet stetig an der Optimierung des Verfahrens. Im Jahr 2000 wurde mit der HiFocus-Technologie ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Das **HiFocus-Plasmaschneiden** steht heute als Synonym für höchste Schnittqualität und beste Winkligkeit. Darüber hinaus ermöglicht die starke Lichtbogeneinschnürung das sehr feine Schneiden im Dünoblechbereich mit sehr geringen Strömen.